



HAUPTVERSAMMLUNG 2014

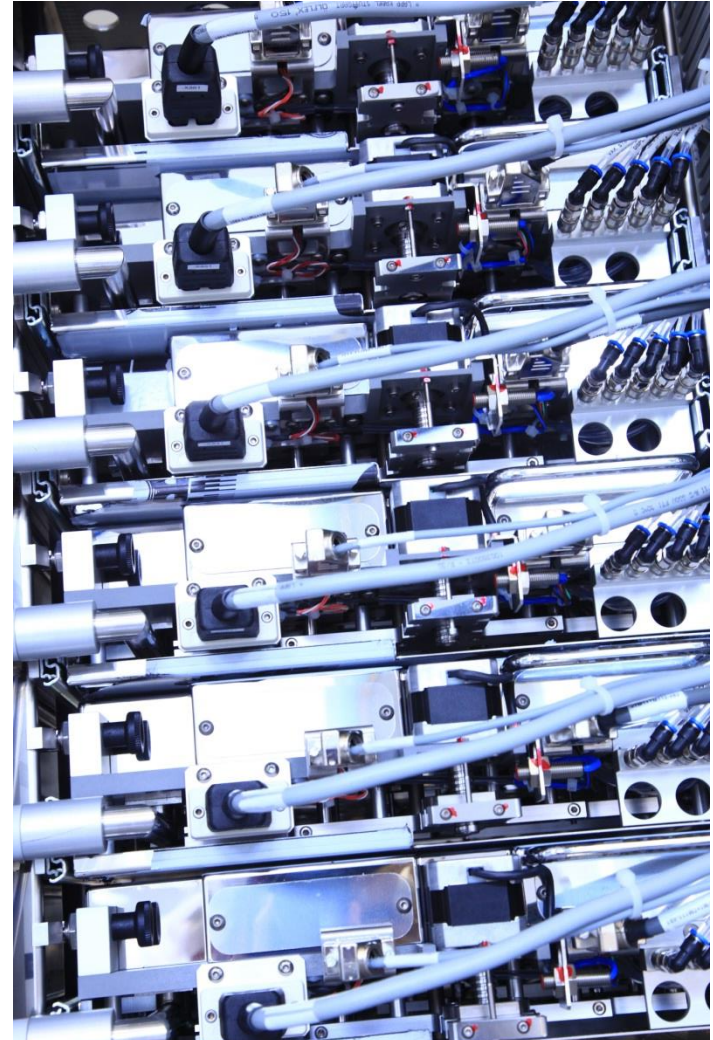
HAUS DER BAYERISCHEN WIRTSCHAFT

17. JUNI 2014

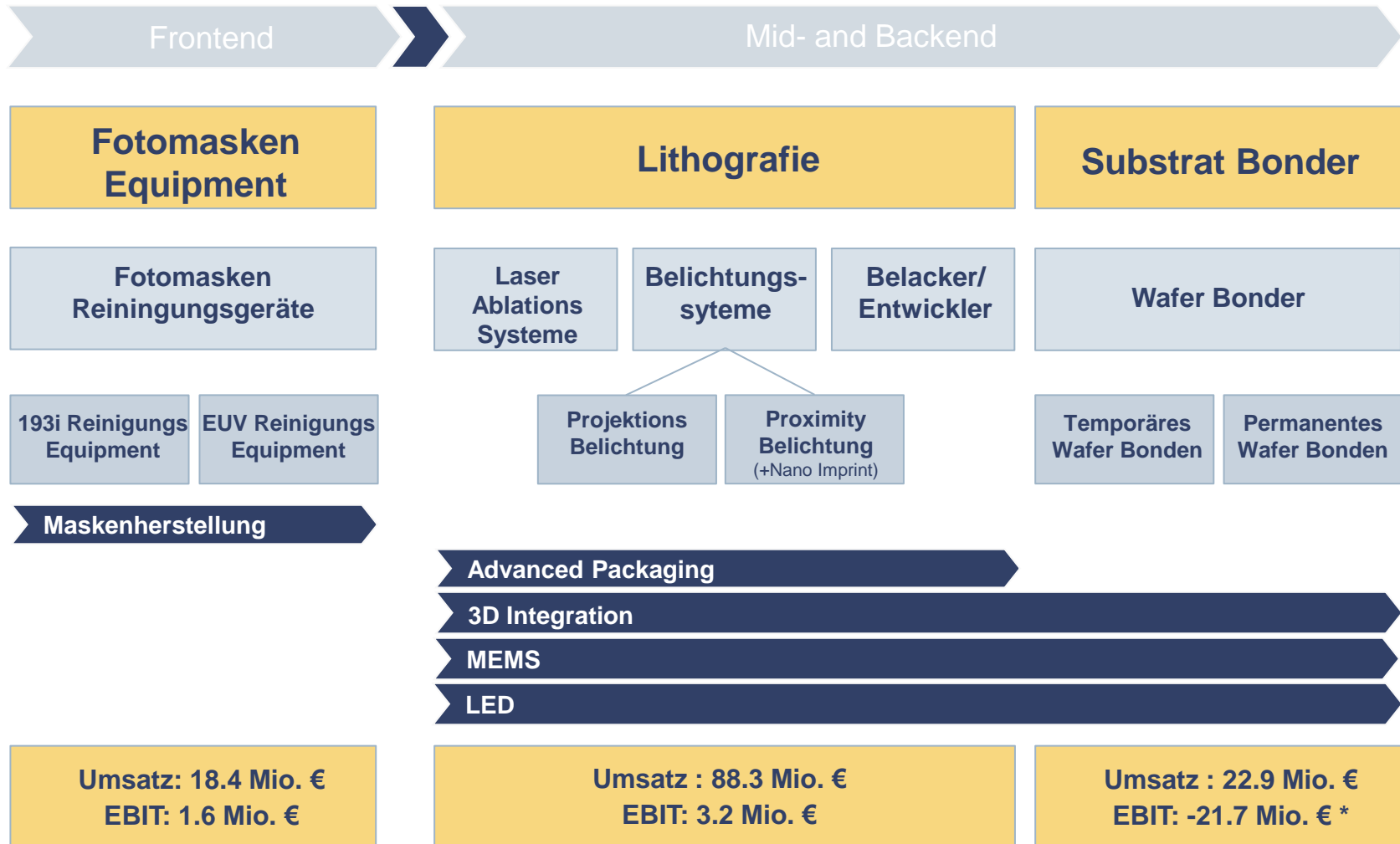
Diese Präsentation enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die sich auf das Geschäft, die finanzielle Entwicklung und die Erträge der SÜSS MicroTec AG oder ihrer Tochter- und Beteiligungsgesellschaften beziehen. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen Plänen, Schätzungen, Prognosen und Erwartungen und unterliegen daher Risiken und Unsicherheitsfaktoren, von denen die meisten schwierig einzuschätzen sind und die im Allgemeinen außerhalb der Kontrolle der SÜSS MicroTec AG liegen. Die SÜSS MicroTec AG übernimmt deshalb keine Gewähr dafür, dass die Erwartungen und Ziele, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen werden, erreicht werden. Die SÜSS MicroTec AG beabsichtigt auch nicht und übernimmt keine Verpflichtung, eine Aktualisierung dieser zukunftsgerichteten Aussagen zu veröffentlichen.

- I. Überblick SÜSS MicroTec
- II. Meilensteine 2013/2014
- III. Das Geschäftsjahr 2013 und das erste Quartal 2014 in Zahlen
- IV. Ein globales Unternehmen – zukunftsfähige Technologien
- V. Die Aktie
- VI. Ausblick

- + SÜSS MicroTec ist einer der weltweit führenden Anbieter für Equipment im Mid- und Backend der Halbleiterindustrie
 - + Unser Equipment und unsere Prozesslösungen schaffen die Mikro- und Verbindungsstrukturen der Mikroelektronik
 - + Unser Fokus richtet sich auf die wachstumsstarken Marktsegmente: Advanced Packaging / 3D-Integration, MEMS und LED
-
- + Kennzahlen zur Aktie:
 - Wertpapierkennnummer: A1K023
 - Aktienkurs*: 8,64 €
 - Marktkapitalisierung*: 165 Mio. €
 - Net Cash, März 2014: 31,5 Mio. €



* 30. Mai 2014



*EBIT enthält Sondereffekt in Höhe von -13,2 Mio. € aus Restrukturierung der Produktlinie Permanentes Bonden

- I. Überblick SÜSS MicroTec
- II. Meilensteine 2013/2014
- III. Das Geschäftsjahr 2013 und das erste Quartal 2014 in Zahlen
- IV. Ein globales Unternehmen – zukunftsfähige Technologien
- V. Die Aktie
- VI. Ausblick

- + International führender koreanischer Halbleiterhersteller platziert Folgeauftrag für temporäres Bonding-Equipment für die 300mm Pilotfertigung
- + Asiatischer Kunde ordert 15 Mask Aligner für die Fertigung von CMOS Bildsensoren
- + Auszeichnung durch wichtige Kunden: SPIL und Amkor verleihen „Supplier Award“
- + Führender US-amerikanischer Halbleiterhersteller platziert Auftrag für Excimer Laser Ablation System ELP300 im Bereich Advanced Packaging



Bond Cluster - XBC300 Gen2



Excimer Laser Stepper - ELP300



- + Kauf der Immobilie am Standort Garching für 8,9 Mio. € (inkl. Nebenkosten)
- + Kooperationen mit: Rolith, USA,
Cornell University, USA
SEMATECH, USA
Dow Corning, USA
- + Restrukturierung : Fertigung der Vollautomaten (Cluster Systeme) für das permanente Bonden wurde eingestellt



Hauptverwaltungsgebäude in Garching



- + Die Vollautomaten für das permanente Bonden generierten seit Jahren Verluste

Restrukturierungsmaßnahmen

- + Q1 2013: Fokussierung des Bereichs Permanentes Bonden auf die Märkte MEMS und LED, um die unbefriedigende Ertragssituation zu verbessern
- + Überprüfung der Maßnahmen aus Q1 2013: Ertragssituation und Marktausblick haben sich nicht wesentlich verbessert
- + Einstellung der Fertigung von Vollautomaten Permanentes Bonden in Q4 2013

Gesamtkosten der Restrukturierung belaufen sich auf 13,2 Mio. €

- + Bereinigung des Produktportfolios > Verbesserung der Ergebnissituation**
- + Verschlinkung interner Strukturen**
- + Fokussierung auf manuelle Permanente Bond Systeme**
- + SÜSS MicroTec bleibt weiterhin ein führender Anbieter Permanenter Bond Systeme und wird auch zukünftig neue Produktgenerationen entwickeln**
- + Umsatz der Division Substrat Bonder wird auf dem Niveau des Vorjahres erwartet**

Das Wachstum der Substrat Bonder Division wird zukünftig wesentlich durch das erfolgreich in den Markt eingeführte Temporäre Bonden für 3D IC bestimmt werden

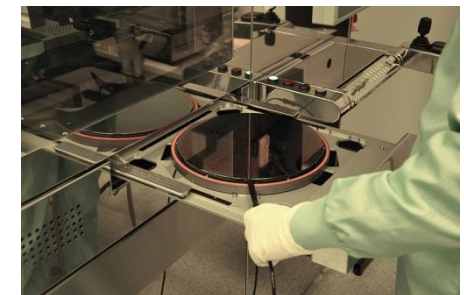
- + Auslieferung des 25ten Maskenreinigungssystems Mask Track*Pro*
- + Produkteinführungen: ELP300 Gen2, DSC300 Gen2, MA200 Gen3, MA12
- + Walter Braun wird zum Produktionsvorstand ernannt
- + NANIUM (Portugal) verleiht SÜSS MicroTec „Preferred Supplier Award“



Maskenreinigungsgerät Mask TrackPro



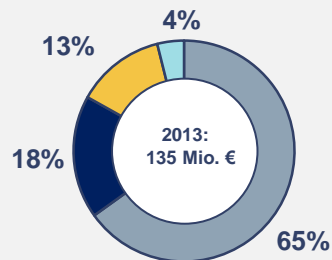
UV-Projektionsscanner DSC300 Gen2



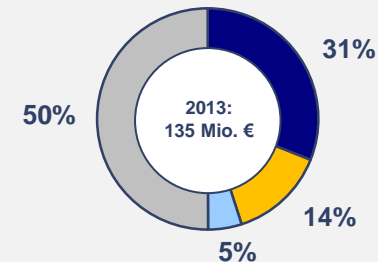
Blick in den Mask Aligner MA12

- I. Überblick SÜSS MicroTec
- II. Meilensteine 2013/2014
- III. Das Geschäftsjahr 2013 und das erste Quartal 2014 in Zahlen
- IV. Ein globales Unternehmen – zukunftsfähige Technologien
- V. Die Aktie
- VI. Ausblick

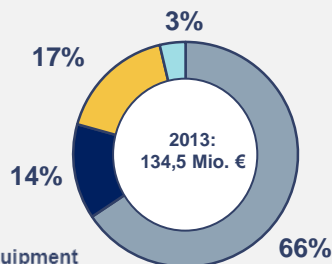
Auftragseingang nach Segmenten



Auftragseingang nach Regionen

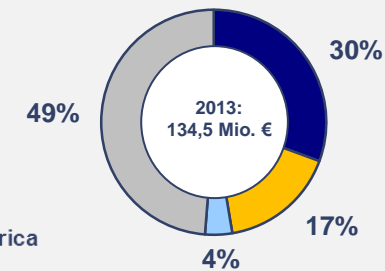


Umsatz nach Segmenten



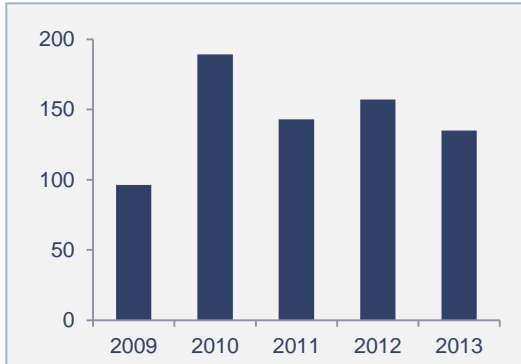
■ Lithography
■ Photomask Equipment
■ Substrate Bonder
■ Others

Umsatz nach Regionen

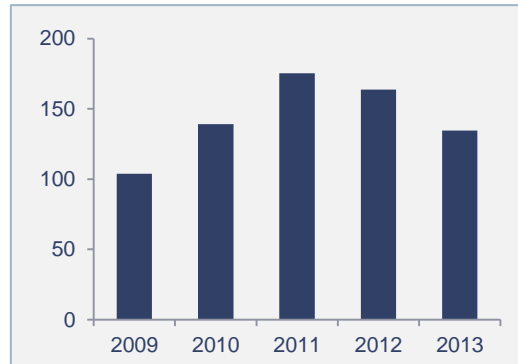


■ Europe
■ North America
■ Japan
■ Rest of Asia

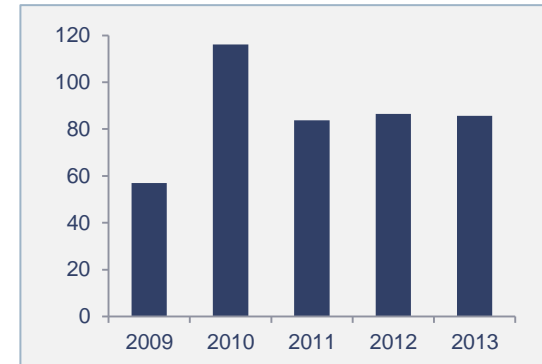
Auftragseingang in Mio. €



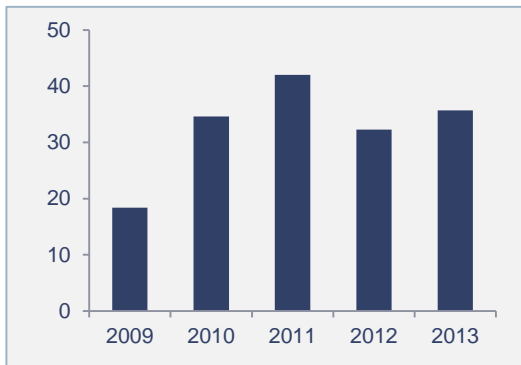
Umsatz in Mio. €



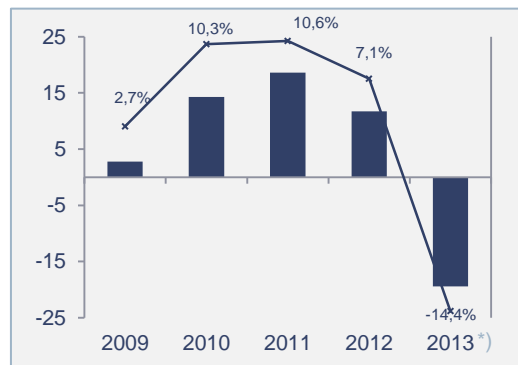
Auftragsbestand in Mio. €



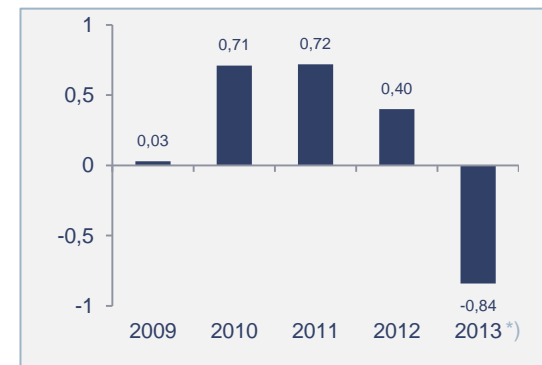
Nettoliquidität in Mio. €



EBIT in Mio. €



Ergebnis je Aktie in €



*Sondereffekt in Höhe von -13,2 Mio. € (-0,69 € pro Aktie) aus Restrukturierung der Produktlinie Permanent Bonding

in Mio. €	2013	2012	in %
Auftragseingang	135,0	157,2	-14,1%
Auftragsbestand zum 31.12.	85,7	86,5	-0,9%
Umsatz	134,5	163,8	-17,9%
EBIT	-19,4	11,7	--
<i>EBIT in % vom Umsatz</i>	<i>-14,4%</i>	<i>7,1%</i>	<i>--</i>
Ergebnis nach Steuern (fortgeführtes Geschäft)	-16,0	7,6	--
Ergebnis nach Steuern (fortgeführtes und nicht fortgeführtes Geschäft)	-16,0	9,1	--
EPS in € (fortgeführtes Geschäft)	-0,84	0,40	--
Freier Cash Flow*	4,1	-4,5	--
Nettoliiquidität**	35,7	32,3	+10,5%
Mitarbeiter zum 31.12.	655	704	-7,0%

* vor Berücksichtigung von Erwerb und Verkauf verzinslicher Wertpapiere und M&A Aktivitäten

** inkl. Bestand an verzinslichen Wertpapieren, nach Akquisition von Tamarack Scientific

**2013: Umsatz der Halbleiter Equipment Industrie:
minus 14%**

Davon:

Wafer-Frontend: minus 11%

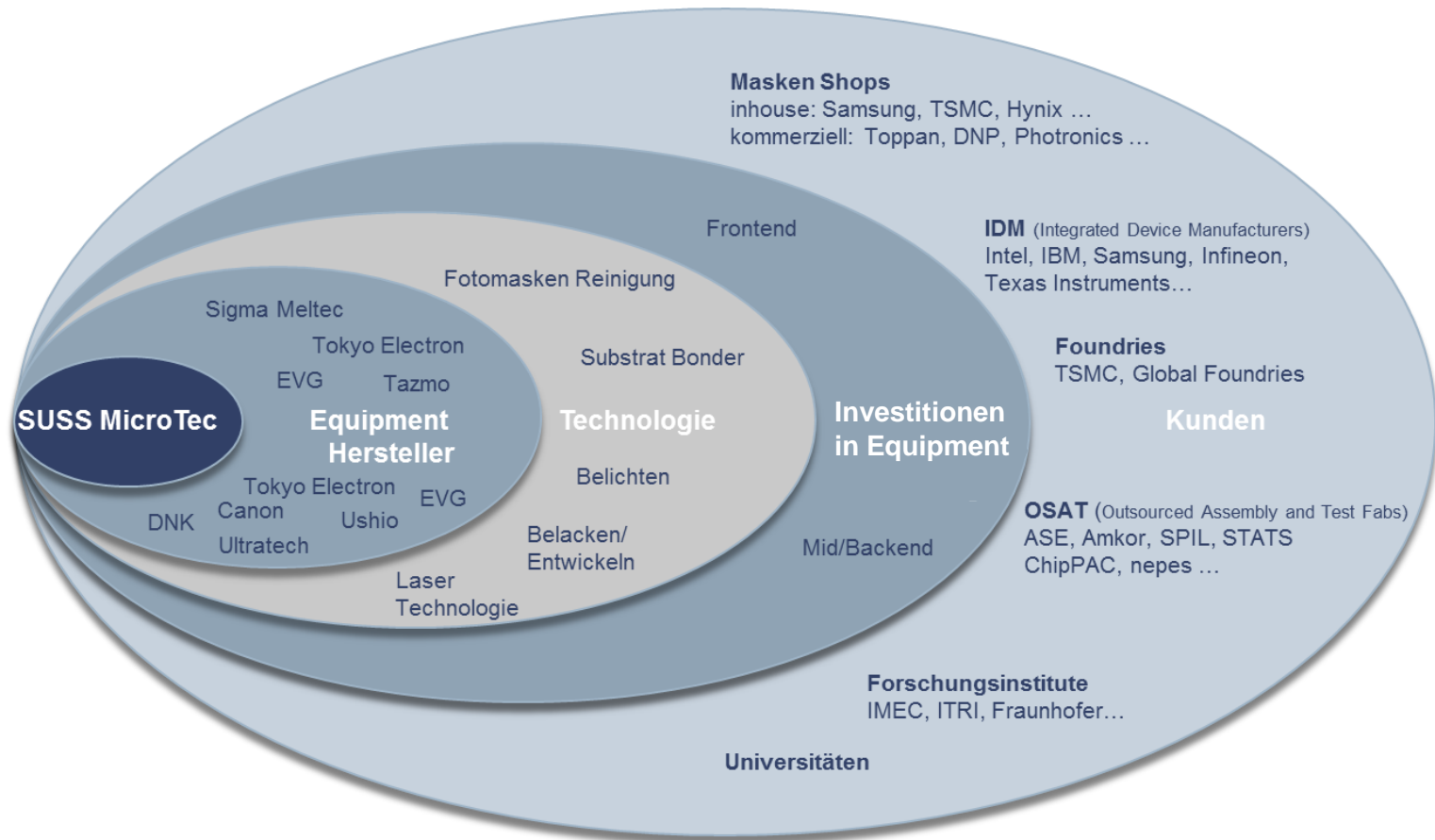
Testsysteme: minus 24%

Packaging: minus 26%

Andere (incl. Maske): minus 34%

Quelle: SEMI März 2014

2013: Umsatz SÜSS MicroTec: minus 17,9%

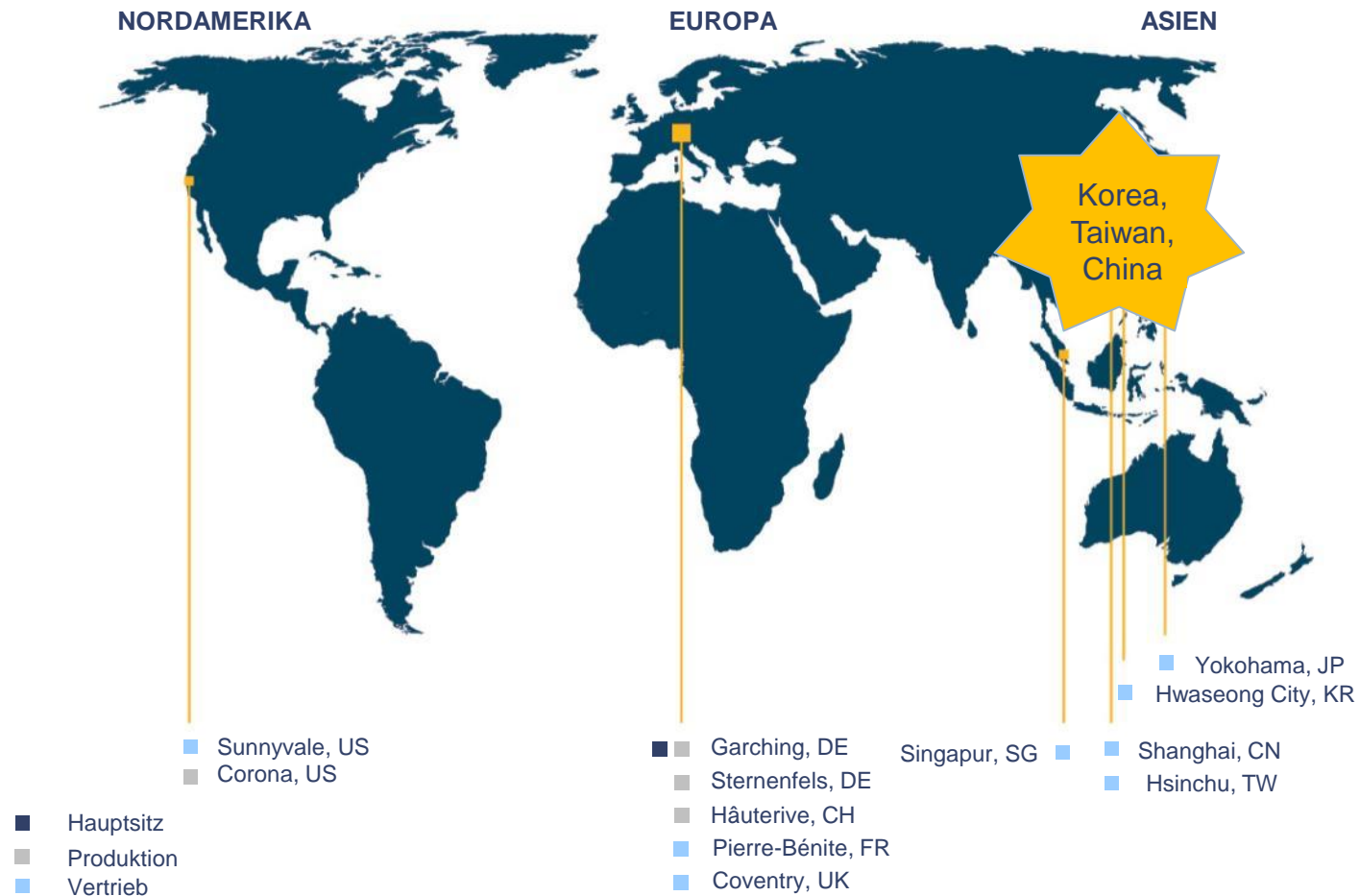


in Mio. €	Q1 2014	Q1 2013
Auftragseingang	25,0	34,9
Auftragsbestand zum 31.12.	71,4	91,5
Umsatz	39,0	30,1
EBIT	1,5	-3,3
<i>EBIT in % vom Umsatz</i>	<i>3,8%</i>	<i>-11,0%</i>
Ergebnis nach Steuern	1,1	-2,5
EPS in €	0,06	-0,13
Freier Cash Flow*	31,5	25,1
Nettoliquidität**	-4,2	-7,2
Mitarbeiter zum 31.12.	645	693

* vor Berücksichtigung von Erwerb und Verkauf verzinslicher Wertpapiere und M&A Aktivitäten

** inkl. Bestand an verzinslichen Wertpapieren, nach Akquisition von Tamarack Scientific

- I. Überblick SÜSS MicroTec
- II. Meilensteine 2013/2014
- III. Das Geschäftsjahr 2013 und das erste Quartal 2014 in Zahlen
- IV. Ein globales Unternehmen – zukunftsfähige Technologien
- V. Die Aktie
- VI. Ausblick



Deutschland



Garching

- + Sitz der SÜSS MicroTec AG
- + Entwicklung und Produktion:
 - **Mask Aligner**
 - **Bond Aligner**
- + Kernkompetenz:
 - **Belichtung**
(Schattenwurfverfahren)
 - **Positionierung**



Sternenfelds

- + Entwicklung und Produktion:
 - **Bonder**
 - **Belacker und Entwickler**
 - **Fotomasken Equipment**
- + Kernkompetenz:
 - **Nassprozesse**
 - **Waferbonden**

USA

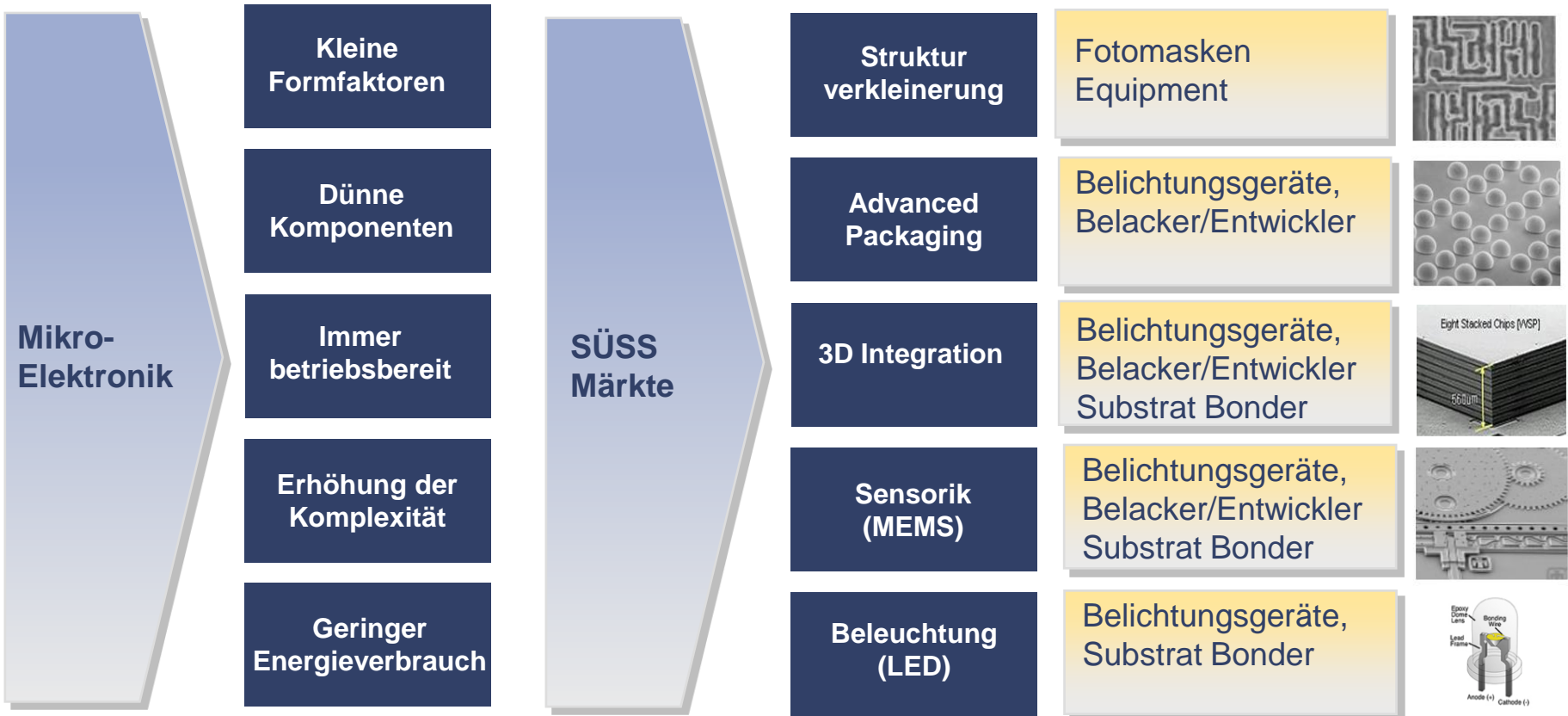


Corona

- + Entwicklung und Produktion:
 - **Stepper / Scanner**
 - **Laser Strukturierung**
- + Kernkompetenz:
 - **Belichtung**
(UV-Projektion)
 - **Laser Ablation**

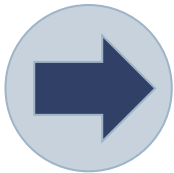
- + Megatrends prägen die Mikroelektronik:
 - **Digitaler Lifestyle**
 - **E-Mobilität**
 - **Energieeffizienz**
- + Mikrochips, MEMS und LEDs sind die Bausteine für den technologischen Produktfortschritt und versprechen ein nachhaltiges Wachstum
- + Die Anforderungen an die Bauelemente sind:
 - **Hohe Komplexität**
 - **Kleiner Formfaktor**
 - **Flache Bauhöhe**
 - **Geringer Energieverbrauch**
 - **Immer betriebsbereit**
- + Mit den SÜSS MicroTec Komplett-Lösungen werden diese anspruchsvollen Bauelemente entwickelt und hergestellt





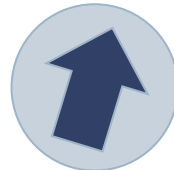
Fotomaschinen Equipment

- Marktführer mit >80% Marktanteil
- Mehrfach-Belichtung in der Immersionslithographie treibt Kapazitätserweiterungen
- EUVL noch nicht in der Volumenproduktion



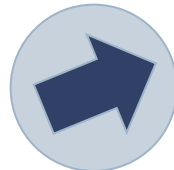
Substrat Bonder

- Temporäre Bondsysteme: Wachstumschance 3D-Integration
 - Technologieführerschaft
 - erste Produktionssysteme ausgeliefert
- Permanente Bondsysteme: MEMS und LED als Haupt-Zielsektoren



Lithografie

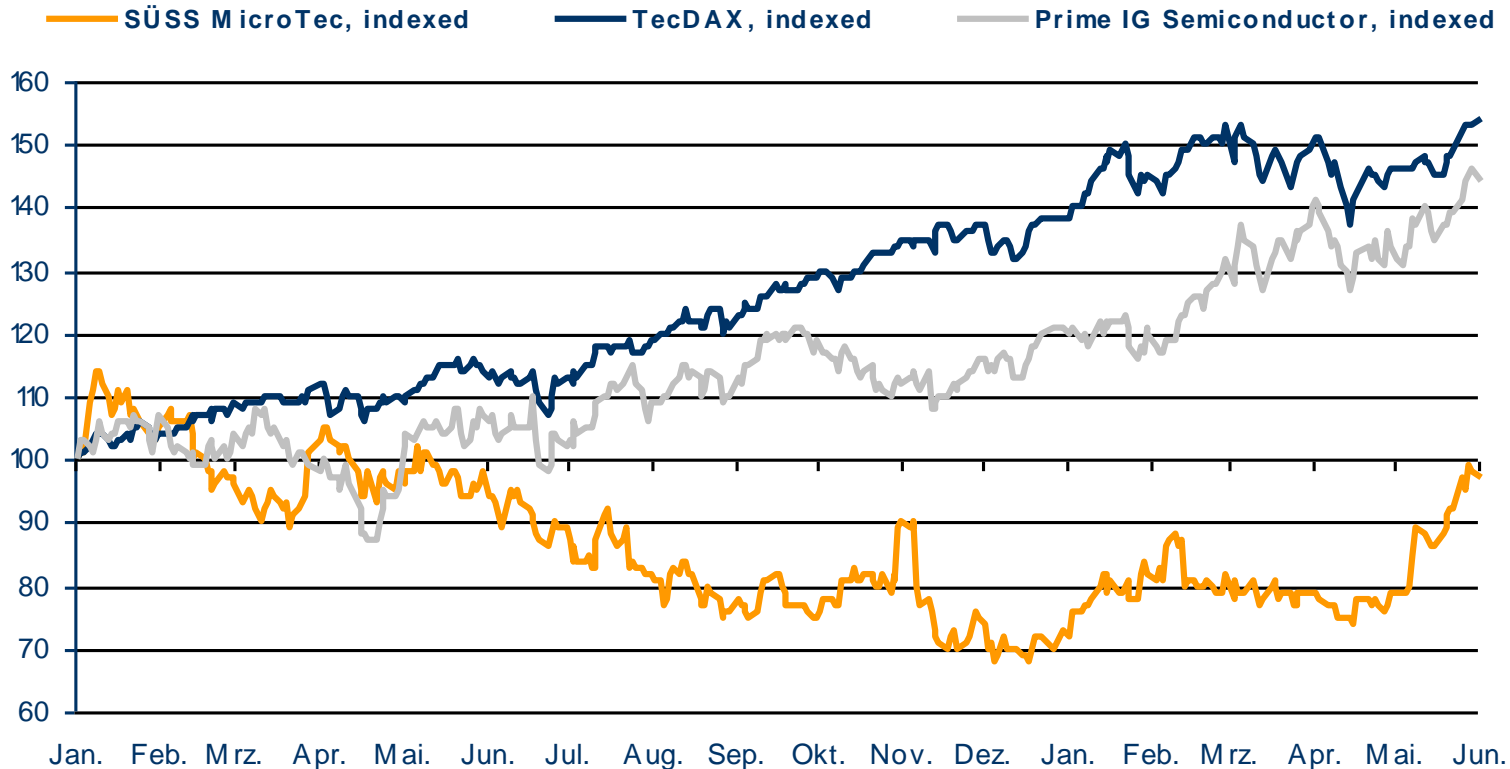
- Hauptmärkte sind Advanced Packaging und MEMS
- Kapazitätserweiterungen i.W. bedingt durch Wachstum von Smartphones und Tablet Computer
- Kundenbasis überwiegend in Asien
- Scanner und Lasertools von SÜSS MicroTec Photonic Systems bieten neuen Lösungsansatz



- I. Überblick SÜSS MicroTec
- II. Meilensteine 2013/2014
- III. Das Geschäftsjahr 2013 und das erste Quartal 2014 in Zahlen
- IV. Ein globales Unternehmen – zukunftsfähige Technologien
- V. Die Aktie
- VI. Ausblick

AKTIENKURSENTWICKLUNG SEIT 2013

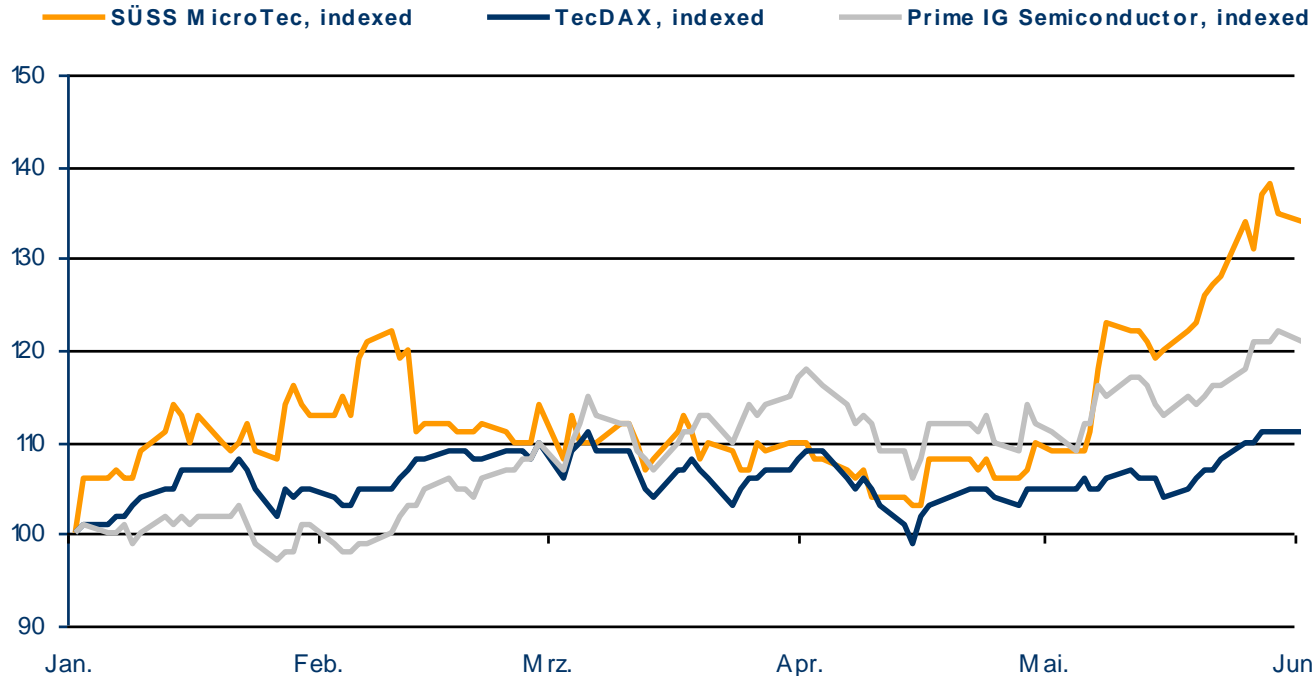
(Preis der SÜSS MicroTec-Aktie am 2. Januar 2013: 8,85 €)



AKTIENKURSENTWICKLUNG UND AKTIONÄRE ÜBER 3%

SÜSS MicroTec

(Preis der SÜSS MicroTec-Aktie am 2. Januar 2014: 6,38 €)



Aktionäre mit Stimmrechten >3%:

Credit Suisse 3.35%
BlackRock 3,23%
Henderson 5.13%
Schroders 3.1%
Vanguard 3.2%
Baillie Gifford 3.0%

Durchschnittliches tägliches Handelsvolumen Januar 2014 – Juni 2014: ~ 88 tsd.

- I. Überblick SÜSS MicroTec
- II. Meilensteine 2013/2014
- III. Das Geschäftsjahr 2013 und das erste Quartal 2014 in Zahlen
- IV. Ein globales Unternehmen – zukunftsfähige Technologien
- V. Die Aktie
- VI. Ausblick

- +** In einem schwachen Halbleiter Equipment Umfeld 2013 hat sich SÜSS MicroTec robuster als die Vergleichsgruppe entwickelt
- +** Eine Belebung der Halbleiter Equipment-Branche für 2014 wird erwartet (Umsatz Fab Equipment +24%; Quelle: SEMI März 2014)
- +** SÜSS MicroTec besetzt in den Zielmärkten führende Marktpositionen (Nummer eins oder zwei)

Ausblick:

- +** GJ 2014: - Umsatz 135 - 145 Mio. €
- EBIT: -5 bis 0 Mio. €
- +** Q2 2014: - Auftragseingang 30 - 40 Mio. €



Thank you!

SÜSS MicroTec AG
Schleissheimer Str. 90
85748 Garching

www.SUSS.com